



XC5VSX50T-1FFG665C

Număr parc	XC5VSX50T-1FFG665C	Statutul RoHs	
Producator / Marca	AMD Xilinx	Starea stocului	40 pcs stock
Descriere produs	IC FPGA 360 I/O 665FCBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

40 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1 pcs

\$731.357

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de XC5VSX50T-1FFG665C

Tensiune - Aprovizionare	0.95V ~ 1.05V	Bits total RAM	4866048
Pachetul dispozitivului furnizor	665-FCBGA (27x27)	Serie	Virtex®-5 SXT
Pachet / Caz	665-BBGA, FCBGA	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	0°C ~ 85°C (TJ)	Numărul de elemente logice / celule	52224
Număr de LAB / CLB	4080	Numărul de intrări / ieșiri	360
Tipul de montare	Surface Mount	Numărul produsului de bază	XC5VSX50

Vești înrudite



PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele Sistemelor modulare - Diavolul este în detaliu încorporat de date, vehicule și PV

2023/09/7

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13

2023/08/30

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

2023/04/5

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22